

基于故障物理仿真的可靠性分析与设计改进

电子产品更新换代非常迅速。新材料、新制造方法、新组件技术和日益苛刻的使用环境对设计师提出了重大挑战。而对故障机理认识不清的问题，使得产品的可靠无法得到更好的控制和提高。



技术的复杂性使得可靠性设计的地位更加重要，概括起来，主要体现在以下方面：

- (1) 产品差异化：随着电子技术的成熟，通过价格和性能等传统指标将产品从竞争中脱颖而出的机会越来越少。
- (2) 可靠性保证：先进的电路、复杂的电源要求、新的组件、新的材料技术和不太坚固的部件，使得可靠性保证工作变得越来越困难。
- (3) 成本控制：设计费用占项目成本比重越来越高，控制成本对企业生存至关重要。
- (4) 保持利润：提高设计效率，可以让产品提前上市，防止销量和市场份额的流失。

基于故障物理仿真的可靠性设计能够在产品的物理样机制造出来之前对产品的设计进行分析，在此阶段的设计改进，能够大大的节约时间和成本。

我们在设备级电子产品、电路模块以及SiP芯片方面完成了可靠性仿真分析与设计改进的案例，您可以下载并联系我们，为您提供适合您产品的可靠性设计与可靠性增长方案。